



2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2022年2月14日

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス 上場取引所 東
 コード番号 6890 URL http://www.ferrotec.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢
 問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186
 四半期報告書提出予定日 2022年2月14日 配当支払開始予定日 -
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2022年3月期第3四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2022年3月期第3四半期	93,981	41.2	16,184	159.0	18,188	215.8	21,445	229.4
2021年3月期第3四半期	66,540	9.5	6,249	27.5	5,758	64.8	6,510	228.9

(注) 包括利益 2022年3月期第3四半期 29,186百万円 (319.4%) 2021年3月期第3四半期 6,959百万円 (-%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2022年3月期第3四半期	558.42	513.12
2021年3月期第3四半期	175.31	158.51

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2022年3月期第3四半期	251,446	149,427	48.3	2,738.92
2021年3月期	177,392	78,239	37.8	1,803.03

(参考) 自己資本 2022年3月期第3四半期 121,565百万円 2021年3月期 67,093百万円

(注) 2022年3月期第3四半期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2021年3月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2021年3月期	-	12.00	-	18.00	30.00
2022年3月期	-	23.00	-	-	-
2022年3月期（予想）	-	-	-	23.00	46.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

2021年3月期期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 記念配当 4円00銭

2022年3月期第2四半期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 特別配当 9円00銭

2022年3月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 特別配当 9円00銭

3. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	125,000	36.9	22,500	133.4	23,500	185.6	23,500	183.8	588.82

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 -社（社名）-、除外 -社（社名）-

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（注）詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

（注）詳細は、添付資料9ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2022年3月期3Q	44,478,486株	2021年3月期	37,305,202株
② 期末自己株式数	2022年3月期3Q	93,852株	2021年3月期	93,568株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2022年3月期3Q	38,404,435株	2021年3月期3Q	37,134,774株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(会計方針の変更)	9
(セグメント情報等)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における経済状況は、米国経済は、米連邦準備理事会が新型コロナウイルスのもたらす需給の不均衡や経済活動の再開で高インフレが続いているとの声明文を公表し、まもなく政策金利を引き上げることが適切だとの見通しを示しました。中国経済は、経済活動が正常化し景気は上向いたものの、不動産業の苦境により急減速するなかでも一定の経済成長を維持しています。我国では、年末に向け新型コロナウイルス感染者数の減少がみられたものの再び増加に転じ、商業活動に影響が出ており経済状況は不透明感が続いています。為替相場は、円安方向で推移しました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、世界的に企業や学校でのWEB会議システムの普及により、パソコンやデータセンター用サーバーなどの需要が旺盛であり、半導体デバイスなど電子部品の需給バランスが崩れ品不足が続いています。加えて新型コロナウイルスの影響による人手不足や海運等の荷揚げが遅延しサプライチェーンに混乱が生じており、産業用機器、自動車、家電製品に至るまで電子部品を中心に部材の供給が滞る事態となりました。一方で大手デバイスメーカー各社は新たな製造拠点の投資計画を発表し、保有する製造設備の稼働率も高水準な状況が続きました。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業におきましては、製造装置向けの真空部品や半導体製造プロセスに使用される各種マテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）の販売は、顧客からの引合いが依然強く堅調に推移しました。半導体製造装置部品の洗浄サービスも堅調に推移しました。

電子デバイス事業におきましては、主力のサーモモジュールは、5G通信システム機器向けやPCR検査装置などの医療検査機器向けのほか、半導体分野向けも堅調に推移しました。また、成長著しいパワー半導体用基板は、IGBT向けDCB基板の需要増加に加え、電気自動車向けのAMB基板の採用が増えたことから製造ラインを拡張し、顧客からの需要に対応しています。

尚、円安による為替の影響につきましては、約18億円の為替差益となりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は93,981百万円（前年同期比41.2%増）、営業利益は16,184百万円（前年同期比159.0%増）、経常利益は18,188百万円（前年同期比215.8%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は21,445百万円（前年同期比229.4%増）となりました。

当第3四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、以下のとおりです。

(半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

世界的なリモートワークの拡大に伴いパソコン、データサーバー等の需要増加により、電子部品の需給は依然逼迫しています。半導体不足から各種産業への影響もあり、半導体デバイスメーカーや素材メーカーは、新たな製造拠点や増産体制の計画を発表しています。当社グループが供給する半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）は、デバイスメーカーの稼働率が高水準であることから、当社グループの顧客である半導体製造装置メーカーからの需要は旺盛であり、売上は堅調に推移いたしました。現在、顧客のご要望から石英、セラミックス、シリコンパーツ増産のための製造ライン拡張の設備投資を実行しています。半導体製造装置などの部品洗浄サービスも需要増加により売上を伸ばしました。

この結果、当該事業の売上高は57,315百万円（前年同期比26.9%増）、営業利益は11,197百万円（前年同期比218.9%増）となりました。

(電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体などです。

主力のサーモモジュールは、5G用の移動通信システム機器向けやPCR等の医療検査装置向けは安定した販売を継続しており、美容家電を含む民生分野向けや半導体分野向けは計画を上回る水準で推移しました。自動車温調シート向けは、一時的に自動車販売減少の影響により弱含みの展開でしたが、自動運転に使用される自動車レーダー向けは、自動車部品メーカーでの評価が進んでいます。パワー半導体用基板は、IGBT向けDCB基板は需要増となり、車載向けのAMB基板は量産が進み売上は伸長しました。本製品は需要が強く今後の成長が見込めるため、製造ラインの拡張ならびに新たな素材の研究開発を進めています。磁性流体は、新型スマートフォンのバイブレションモーター用の需要は安定的に推移しました。

当該事業の製品は、景気に左右されにくい業種への販売を展開しています。

この結果、当該事業の売上高は19,131百万円（前年同期比57.6%増）、営業利益は4,694百万円（前年同期比44.1%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

<資産>

当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ74,054百万円増加し、251,446百万円となりました。これは主に現金及び預金31,180百万円、有形固定資産21,625百万円、関係会社株式10,843百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ2,866百万円増加し、102,019百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金3,077百万円、社債（1年内償還予定を含む）1,659百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）3,229百万円の減少があった一方、電子記録債務4,171百万円、その他流動負債6,085百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ71,188百万円増加し、149,427百万円となりました。これは主に資本金10,426百万円、資本剰余金18,571百万円、利益剰余金19,882百万円、非支配株主持分16,749百万円の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2021年11月12日の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	30,202,819	61,383,351
受取手形及び売掛金	32,201,188	—
受取手形、売掛金及び契約資産	—	36,801,664
商品及び製品	5,328,806	6,631,711
仕掛品	5,064,821	7,246,108
原材料及び貯蔵品	6,680,313	9,608,833
その他	9,189,878	10,415,572
貸倒引当金	△643,491	△745,814
流動資産合計	88,024,335	131,341,426
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	15,446,974	20,888,387
機械装置及び運搬具（純額）	15,067,513	20,116,979
工具、器具及び備品（純額）	4,693,247	4,795,465
土地	1,893,760	1,895,098
リース資産（純額）	3,324,427	3,841,764
建設仮勘定	12,720,925	23,235,035
有形固定資産合計	53,146,849	74,772,731
無形固定資産		
のれん	340,820	299,292
その他	1,625,561	1,678,260
無形固定資産合計	1,966,382	1,977,552
投資その他の資産		
関係会社株式	23,317,126	34,160,612
その他	11,520,121	9,824,806
貸倒引当金	△582,712	△630,196
投資その他の資産合計	34,254,535	43,355,222
固定資産合計	89,367,766	120,105,505
資産合計	177,392,102	251,446,932

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	18,697,669	15,620,049
電子記録債務	257,015	4,428,385
短期借入金	5,426,689	5,480,984
1年内償還予定の社債	5,468,000	5,468,000
1年内返済予定の長期借入金	6,513,161	5,840,545
未払法人税等	1,289,763	1,600,856
賞与引当金	990,470	1,455,047
その他	20,335,353	26,420,552
流動負債合計	58,978,123	66,314,421
固定負債		
社債	11,464,000	9,805,000
転換社債型新株予約権付社債	3,734,976	2,286,720
長期借入金	15,023,494	12,466,348
退職給付に係る負債	536,832	537,319
役員退職慰労引当金	18,300	—
資産除去債務	140,533	141,249
その他	9,256,146	10,467,947
固定負債合計	40,174,282	35,704,585
負債合計	99,152,405	102,019,007
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,702,650	28,129,604
資本剰余金	27,571,266	46,142,573
利益剰余金	18,221,662	38,103,720
自己株式	△86,644	△87,496
株主資本合計	63,408,935	112,288,402
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	318,207	452,483
繰延ヘッジ損益	△8,485	—
為替換算調整勘定	3,456,373	8,877,525
退職給付に係る調整累計額	△81,237	△52,623
その他の包括利益累計額合計	3,684,857	9,277,385
新株予約権	81,458	47,928
非支配株主持分	11,064,445	27,814,209
純資産合計	78,239,696	149,427,925
負債純資産合計	177,392,102	251,446,932

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
売上高	66,540,013	93,981,496
売上原価	44,661,091	59,359,411
売上総利益	21,878,922	34,622,085
販売費及び一般管理費	15,629,789	18,438,012
営業利益	6,249,132	16,184,073
営業外収益		
受取利息	98,128	129,545
補助金収入	674,328	537,492
持分法による投資利益	700,052	—
為替差益	—	1,802,244
その他	236,664	665,806
営業外収益合計	1,709,175	3,135,090
営業外費用		
支払利息	1,191,988	546,233
持分法による投資損失	—	281,391
為替差損	639,697	—
その他	367,838	303,472
営業外費用合計	2,199,524	1,131,097
経常利益	5,758,783	18,188,065
特別利益		
固定資産売却益	66,251	22,264
持分変動利益	5,245,176	9,332,182
特別利益合計	5,311,427	9,354,447
特別損失		
固定資産処分損	56,847	129,677
減損損失	2,075,908	—
事業撤退損	—	924,499
その他	—	128,415
特別損失合計	2,132,755	1,182,592
税金等調整前四半期純利益	8,937,455	26,359,920
法人税等	2,935,586	4,240,417
四半期純利益	6,001,868	22,119,503
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△508,357	673,818
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,510,225	21,445,685

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
四半期純利益	6,001,868	22,119,503
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	212,984	138,518
為替換算調整勘定	728,877	5,146,517
退職給付に係る調整額	17,998	14,235
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,958	1,768,198
その他の包括利益合計	957,902	7,067,469
四半期包括利益	6,959,770	29,186,973
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	7,456,982	27,038,212
非支配株主に係る四半期包括利益	△497,212	2,148,760

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2021年12月7日を払込期日とする公募による新株式発行並びに2021年12月28日を払込期日とする第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）により、資本金が9,571,166千円、資本準備金が9,571,166千円それぞれ増加しました。

また、連結子会社である江蘇富樂徳半導体科技有限公司及び寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司が第三者割当増資を実施したため、資本剰余金が7,973,292千円増加しました。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が28,129,604千円、資本剰余金が46,142,573千円となっております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、国外の販売については、履行義務は主に運送人引き渡し時点で充足されるため、当該時点において収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	45,152,858	12,139,445	57,292,303	9,247,709	66,540,013	—	66,540,013
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	48,673	—	48,673	512,249	560,923	△560,923	—
計	45,201,532	12,139,445	57,340,977	9,759,959	67,100,936	△560,923	66,540,013
セグメント利益	3,510,893	3,257,098	6,767,991	106,177	6,874,169	△625,036	6,249,132

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△625,036千円には、セグメント間取引の消去575,994千円、各報告セグメントに配分していない全社費用49,041千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「半導体等装置関連事業」セグメント及び「その他」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては「半導体等装置関連事業」セグメント260,699千円及び「その他」セグメント1,815,209千円であります。

II 当第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	57,315,378	19,131,124	76,446,502	17,534,994	93,981,496	—	93,981,496
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	57,315,378	19,131,124	76,446,502	17,534,994	93,981,496	—	93,981,496
セグメント利益	11,197,433	4,694,094	15,891,528	513,828	16,405,356	△221,283	16,184,073

- (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。
- 2 セグメント利益の調整額△221,283千円には、セグメント間取引の消去7,904千円、各報告セグメントに配分していない全社費用213,378千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- 3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「半導体等装置関連事業」セグメントにおいて、減損損失256,610千円を計上しており、特別損失の事業撤退損に含めて表示しております。